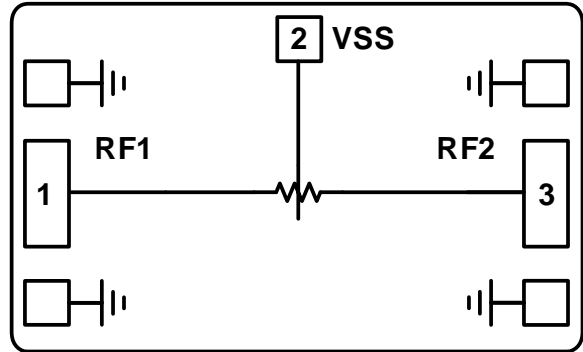




主要特点

- 插入损耗: 3.7dB
- 衰减补偿范围: 3dB
- 温度补偿范围: -55~ +125°C
- 输入输出回波损耗: 20 dB
- 电压控制: -5.2 V
- 工作频率: DC~20GHz
- 芯片尺寸: 0.85x0.75 x 0.1 mm³

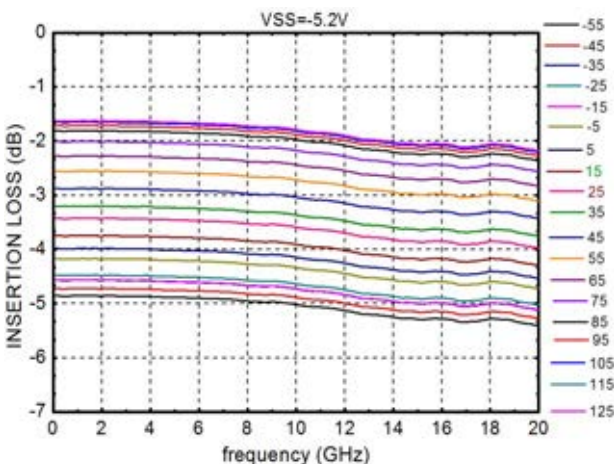
功能框图



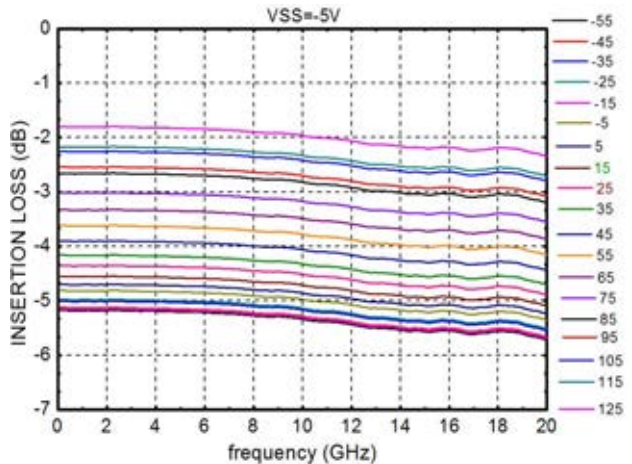
性能指标 (T = +25°C, VSS = -5 V)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC~20			GHz
插入损耗	3.5	3.7	3.9	dB
衰减补偿范围	3			dB
温度补偿范围	-55~+125			°C
输入回波损耗	20			dB
输出回波损耗	20			dB

各温度下的插入损耗曲线

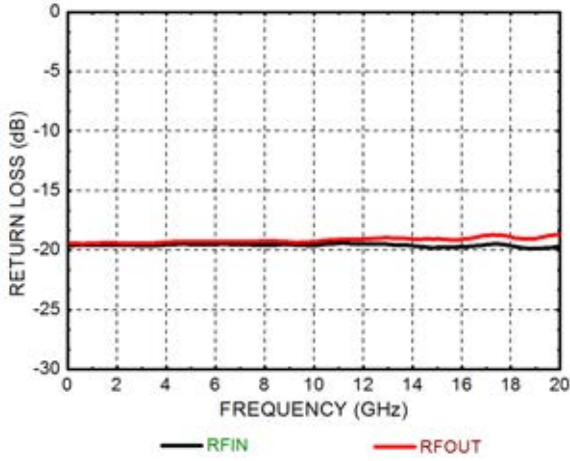


各温度下的插入损耗曲线

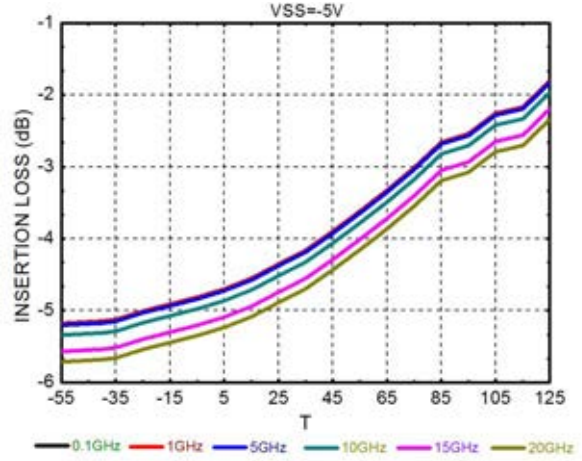




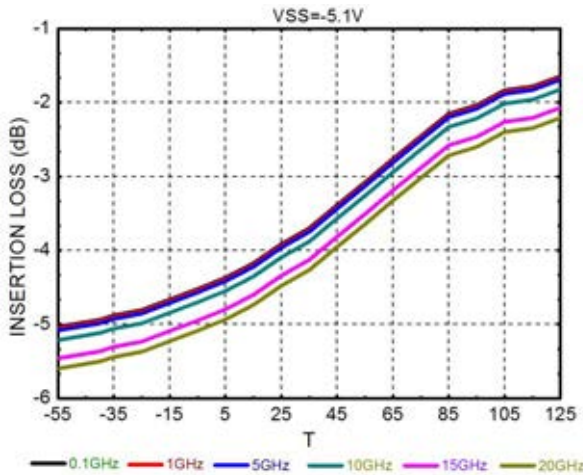
回波损耗曲线



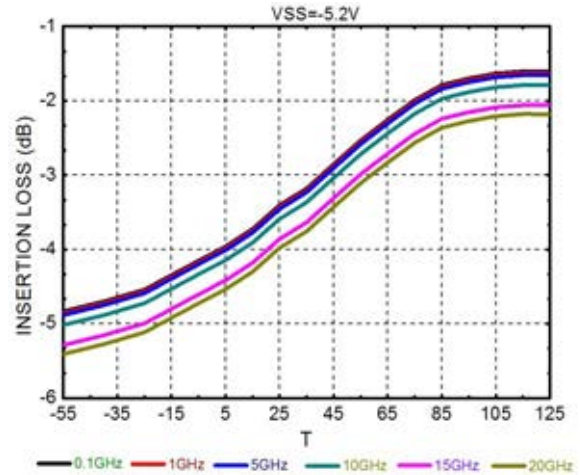
插损随温度变化曲线



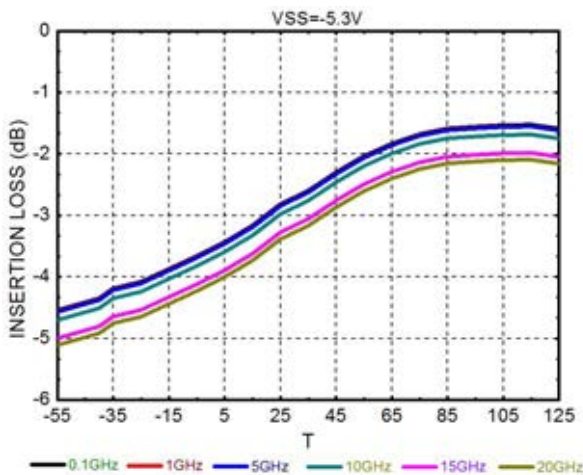
插损随温度变化曲线



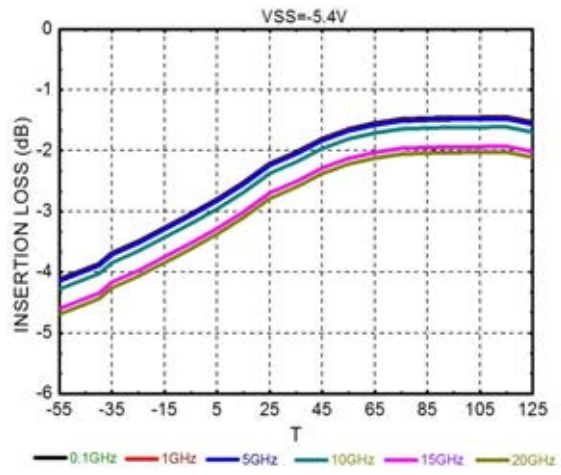
插损随温度变化曲线



插损随温度变化曲线



插损随温度变化曲线

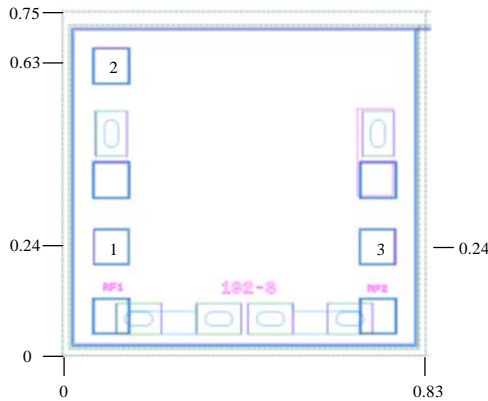




推荐工作电压

温度补偿范围	推荐工作电压	衰减补偿范围	插入损耗
-55~125°C	-5.2 V	3dB	3.7 dB
-55~85°C	-5.3 V	2.8dB	3.1 dB
-55~65°C	-5.4 V	2.5dB	2.5 dB

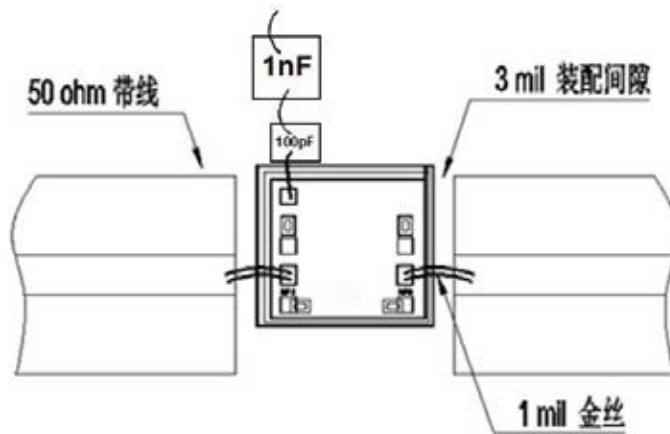
物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 3	RF1, RF2	该系列焊盘射频支路端
2	VSS	电源输入端, 需要外接 100 pF 和 1 nF 旁路电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100um
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100um²
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压: -7V
2. 射频输入功率: +20 dBm
3. 储存温度: -55~+150°C
4. 工作温度: -55~+125°C